

Coining 集成盖板

Coining 集成盖板 (CCA) 和陶瓷集成盖板 (CCCA) 是气密性电子封装的理想之选。与基材和焊框组件相互分离的工艺相比，这种一体式结构显现出独特的制造和成本优势。

Coining 供应金属和陶瓷为盖板/基材的集成盖板。其制造过程完全自动化，可灵活应对各种不同的量产需求。

此外，还有多种定制尺寸、合金和电镀方案供客户选择。

盖板/基材

金属： Kovar™、42 号合金、铜/钼、铝合金、钛合金、不锈钢。

陶瓷： 三氧化二铝、氮化铝、氧化铍

电镀： 内层为符合 QQ-N-290 标准的镀镍层，厚 50 - 350 微英寸。外层为符合 MIL-G-45204 标准的镀金层，类型 III、等级 A、厚度至少为 50 微英寸。另外还有可靠性高的 4 层电镀方案可供选择。

尺寸公差： 长度与宽度：±0.003"

平整度： < 0.001" (基材 < 0.500") 或 ≤ 0.002" (基材 ≥ 0.500")

毛刺： < 0.001"

预成型焊片/焊框

合金： 金锡、金锗、锡基合金 (例如 SAC 305)

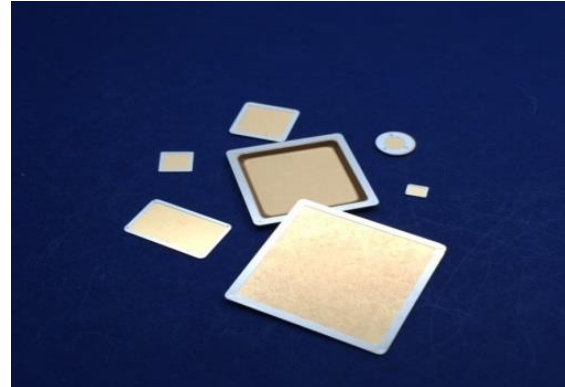
尺寸公差： 长度与宽度：±0.003"
厚度：±0.0003"

装配

定位焊，至少三处完整焊点。

位置公差： ± 0.005"

焊接飞溅： < 0.003"



Coining 集成盖板 (CCA)

全自动化制造过程

我们采用完全自动化的制造过程，可迅速实现从报价到规模化生产器件组装的转换。因此，可灵活应对从 50 件到 500,000 件的各种量产需求。

Coining 既可提供盖板/基材和预成型焊片的集成盖板，也可采用 Coining 预成型焊片装配和焊接客户提供的盖板/基材。

卓越的焊接特性

Coining 先进的制造技术可以带来卓越的焊接特性，从而确保出色的气密密封效果。

我们专有的工艺既可消除焊接区域的材料凸起，又能有效控制盖板/基材材料的焊接熔深。

其他设计方案

如果您有不同设计需求，敬请联系 Coining 工程部门。我们的工程师将为您定制设计盖板/基材、预成型焊片/焊框和相关工装模具。

如有任何疑问，可通过我们网站 www.coininginc.com 的“咨询工程师” (Ask An Engineer) 部分提交您的疑问。